

DuPont™ Pyralux® AT

全聚醯亞胺的可撓性無膠複合材料

說明:

Pyralux® AT是純聚醯亞胺的聚醯亞胺膜在銅箔上的雙面板. Pyralux® AT同 copper-c銅箔基材是應用在雙面板產品的理想選擇材料,如須應用到高密度的線路並有連接晶片的可撓性電路板與液晶顯示模組電路的應用,都是需要這種輕薄的Pyralux® AT複合材料來製作.

規格敘述:

•傑出的尺寸安定性. •優良的耐熱性•PI高黏著強度特性•優秀的介質厚度公差與電氣性能•低熱膨脹係數(CTE)

結構:

標準規格的Pyralux® AT 銅箔規格產品都列在表 1 .要下單給杜邦時可使用參考此表格

表1

雙面Pyralux® AT 產品型號

Product Codes	Copper μm (oz/ft ²)	Polyimide μm (mil)
AT121212EM	12	12
AT181218EM	12	18
AT121812EM	18	12
AT181818EM	18	18
AT122512EM	25	12
AT182518EM	25	18

“EM”為高延展性電解銅

Laminates Property	IPC TM-650 (* or other)	AT121212EM AT181218EM	AT121812EM AT181818EM	AT122512EM AT182518EM
Adhesion to Cu (Peel Strength) As fabricated, N/mm After solder, N/mm	Method 2.4.9	0.7	0.7	0.7
MIT bending, cycles R=0.8mm	*JIS C6471	1100	800	600
Dimensional Stability (MD/TD) After etching, % After 150oC/30min. aging, %	Method 2.2.4	+/-0.07 +/-0.09	+/-0.07 +/-0.09	+/-0.05 +/-0.08
Solder Float at 288oC/10sec.	Method 2.4.13 w/ and w/o pre-bake at 135oC/60min.	Pass	Pass	Pass

包裝: Pyralux® AC銅箔基材提供標準寬度為250 mm長度為100 M並成捲狀,其捲心為9.5 cm . 其他尺寸亦可特別訂購.所有包裝材料可以100%做回收.

儲存條件:Pyralux® AC 可撓性銅箔基材放置在包裝中之儲藏溫度為4-29°C (40-85°F)與溼度70%以下,將保留它們原有特性至少一年. 產品不需冷藏或是冷凍,並保持材料的清潔與良好的保護措施.